

用于玻璃高性能研磨材料

MIREK™

用途

- 液晶玻璃、硬盘、光罩等的研磨材料

概要・特徴

- 通过CeO₂磨粒实现高速率、低损伤的加工
- 从初步研磨到最终抛光，提供适合各种用途的丰富产品系列
- 通过使用各种添加剂，配合客户的使用方式进行产品定制



粉末类



浆料类

品种	性状	平均粒径 (μm)	主要用途
		激光衍射	
HL05	粉末	0.5~0.9	最终抛光用
HL10		0.8~1.3	最终抛光用
HL21		1.0~1.4	最终抛光用
HL30		1.2~1.7	初步研磨用
HL40		1.5~2.3	初步研磨用
HL030CS	浆料	0.2~0.3	最终抛光用
HL020CS		0.1~0.2	最终抛光用
K020C		0.08~0.15	最终抛光用 胶体硅品 / 开发品

※上述数据为代表值，并非规格值。